

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性亦不承擔任何責任。對於準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BASiC Semiconductor Co., Ltd.
深圳基本半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9971)

自願公告

基本半導體與漢磊科技達成戰略合作協議

本公告由深圳基本半導體股份有限公司(「本公司」或「基本半導體」)自願作出，旨在使本公司股東及潛在投資者瞭解本公司最新業務發展情況。

於2026年8月4日，本公司已與漢磊科技股份有限公司(「漢磊科技」，一家於中國台灣成立的股份有限公司，其股份於中國台灣證券交易所上市，股票代碼：3707.TW)達成戰略合作。

此次戰略合作，雙方將在之前長期合作的基礎上，加快8英寸碳化硅晶圓的開發及量產。基於基本半導體的先進產品技術和市場優勢以及漢磊科技高質量大規模晶圓製造能力，共同推進新工藝平台開發和量產落地，提升碳化硅產品在新能源汽車、AI算力中心等領域的市場份額。此外，雙方將圍繞新型化合物半導體在前沿應用領域的核心工藝及應用技術展開研究。

本公司董事會認為此次戰略合作有望在未來幾年為本公司提供先進及充足的8英寸碳化硅晶圓製造能力，有利於合作雙方在市場開拓及技術迭代方面實現重大突破。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
深圳基本半導體股份有限公司
董事長
汪之涵博士

深圳，二零二六年八月四日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事汪之涵博士、和巍巍博士、傅俊寅先生及閆瑞女士；及(ii)獨立非執行董事李居平先生、葉翔先生及王蘇生先生。